

中興短期在職訓練班- LED 封裝與散熱

指導單位	經濟部工業局
執行單位	財團法人資訊工業策進會
開課單位	國立中興大學
課程大綱	1. LED 固晶材料與熱阻分析 2. 封裝/模組設計與應用 3. 封裝/模組製程/技術 4. 封裝/模組製程設備 5. 螢光粉、封裝材料、散熱設計與材料介紹 6. LED 量測基礎與設備及相關標準 7. 可靠度與相關標準
課程內容	本課程為介紹 LED 產業中之下游產業相關技術，封裝為銜接上游磊晶與晶粒製程，提供照明光源組裝。以藍光 LED 為基礎之固態照明經歷多年的發展，逐漸取代白熾燈，並逐步擴大應用範圍普及於民生用品市場，根據產業生命週期的理論，LED 照明正處於快速成長期，仍有許多機會等待投入，本課程希望提供在此業界的工程師們更了解自己所需要的職能，也提供那些想從事 LED 封裝的人有一個完整的輪廓。
上課日期	101/07/13(五)18：30-21：30 及 101/07/14(六)、07/15(日)09：00-16：00 【共 15 小時】
結訓日期	2012/07/15 【學員出席率需達 80%(含)，方可達結訓標準。】
參加對象	1. 半導體年鑑廠商名錄所列之公司員工。 2. 智慧電子業者。 3. 其他相關業者。(須提供「認列資格說明書」或其他佐證資料。)
上課地點	國立中興大學雲平樓推廣教室(台中市南區國光路 250 號)
師資介紹	國立中興大學資深教授及產業專家等
課程費用 (政府補助五成)	總培訓費用\$10,000 元，政府補助後學員自付學費\$5,000 元
招生/開班人數	預定招收 30 人，達到 10 人以上即開課。
報名方式	**請填寫報名表及學員基本資料表連同課程費用，以下列方式完成報名** 親自報名：可至國立中興大學雲平樓 1 樓企劃行銷組辦公室報名。 通訊報名：請務必以『掛號』寄至「40227 台中市國光路 250 號中興大學創新產業推廣學院 企劃行銷組 游雅筑小姐收」 ～員額有限，額滿為止，請儘早報名以免向隅。依繳費先後順序為錄取依據，開課後恕不退費亦不接受變更課程，如遇天災等不可抗力因素，本培訓班將擇期補課～
聯絡方式	Tel：04-22840455#2162 ；Fax： 04-22855507 E-mail: carobaby@dragon.nchu.edu.tw 承辦人：游雅筑小姐

報 名 表

課程名稱	中興短期在職訓練班- LED 封裝與散熱				
姓 名		英文姓名 (同護照)		兩吋半身照片 黏貼處	
生 日	年 月 日	身分證號			
通訊地址	□□□-□□				
E-Mail					
電 話		手 機			
性 別	□男 □女		兵 役	□已役 □未役 □免役_____	
學 歷	學校名稱		科系所		
	□二技 □四技 □大學 □研究所			□畢業 □肄業	
次 學 歷	學校名稱		科系所		
	□二技 □四技 □大學 □研究所			□畢業 □肄業	
服務單位	公司名稱： 部 門： 職 稱：		服務年資	□1-3 個月 □3~6 個月 □1 年-2 年 □2 年以上	
報名原因	□職務需要 □媒合就業 □個人興趣				
資訊來源	□親朋好友 □本校網頁 □報紙-中時 □報紙-自由 □報紙-蘋果 □廣播 □DM/夾報 □電視廣告 □半導體學院網站 □104 網站 □結訓學員_____ □其他_____				
繳交資料	□課程費用【支票或郵政匯票\$5,000 元，抬頭：國立中興大學】 □學員基本資料表				